

## 技術特色

可因應下世代電子產品大量資料運算及毫米波的需求的高頻低損耗載板材料。材料在電性方面可達到 $Dk/Df@10GHz = 3.32/0.0024$ ，並且具良好的耐熱性( $T_g = 254^\circ C$ )以及尺寸安定性( $CTE(X, Y)@\alpha 1 = 12ppm/^\circ C$ )，適合應用於毫米波晶片中的高溫工作環境。



載板材料樹脂膠水



載板材料膠片



載板材料(無覆銅)

載板材料特性	
Dk@10GHz	3.32
Df@10GHz	0.0024
CTE <sub>1</sub> (X, Y) (ppm/K)	12
T <sub>g</sub> (°C)	254
Peel Strength (kgf/cm)	0.53

